

密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部资料( ) 公开( √ )

# PX3SE\_Linux 开发说明

(技术部,第二系统产品部)

文件状态:	当前版本:	V1.6			
[ ] 草稿 [ ] 正式发布 [√] 正在修改	作 者:	王剑辉			
	完成日期:	2018-01-29			
	审 核:	邓训金、陈海燕			
	完成日期:	2018-01-30			

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd

(版本所有,翻版必究)



## 版本历史

日期	修订版本	修订内容	修改人	核定人
2017-03-13	V1.0	初始版本	王剑辉	邓训金 张文平
2017-05-18	V1.1	支持 4 种存储方案		邓训金 王剑辉
2017-07-10	V1.2	添加补丁说明	王剑辉	邓训金 蓝斌元
2017-08-15	V1.3	去除补丁、sdk 兼容硬件 V10_20161124 版本	王剑辉	邓训金 蓝斌元
2017-09-19	V1.4	增加 sd 升级和 U 盘升级、添加 px3se linux 常见问题汇总	王剑辉	邓训金
2017-11-06	v1.5	增加 slc_nand 小容量多分区存储方案,以及多分区存储方案生产工具下载使用说明,添加分区表说明	黄国椿	邓训金 王剑辉
2018-01-29	V1.6	完善文档、fix 测试发现的 bug		邓训金 陈海燕



## 目 录

1 概述	1
2 SDK 获取说明	1
2.1 repo 下载	1
2.2 SDK 下载和同步	1
3 SDK 编译说明	1
3.1 px3se-slc 小容量存储(小容量推荐使用)	1
3.2 px3se emmc 大容量存储(大容量推荐使用)	2
3.3 px3se emmc 小容量存储(方便调试小容量,实际量产不常用)	2
3.4 px3se sfc 小容量存储(spi nor flash 使用)	3
3.5 px3se slc 小容量存储按多分区编译	3
4 固件烧写说明	5
4.1 px3se usb 下载口和串口	5
4.2 px3se 大容量存储固件烧写	6
4.3 px3se 小容量存储固件烧写	6
5 支持列表	7
5.1 DDR 支持列表	7
5.2 Flash 支持列表	8
5.2 Wifi 支持列表	8
6 兼容硬件 RK_SDK_MAIN_PX3SE_CAR_V10 版本	8
6.1 回退 wifi 提交	9
6.2 内置和外置 codec 适配介绍	9
7 分区表配置介绍	9
8 功能模块说明	9
8.1 SD 卡/U 盘升级	9
8.2 Q/A 文档	9
9 量产工具说明	9
10 工程目录介绍	9
附录 A 编译开发环境搭建	11
附录 B SSH 公钥操作说明	12



## 1 概述

本 SDK 是基于 buildroot 文件系统,内核基于 kernel 3.10,兼容多种存储方案,根据存储容量分别定制不同容量需求的文件系统和烧写方式。

## 2 SDK 获取说明

SDK 通过我司代码服务器对外发布。搭建编译开发环境参考附录 A 编译开发环境搭建。客户向我司技术窗口申请 SDK,需同步提供 SSH 公钥进行服务器认证授权,获得授权后即可同步代码。关于我司代码服务器 SSH 公钥授权,请参考附录 BSSH 公钥操作说明。

#### 2.1 repo 下载

repo 是用来管理调用 git 的一个脚本,主要用来下载管理软件仓库,务必使用我司提供的 repo 进行初始化操作。repo 工程下载地址如下:

git clone

ssh://git@www.rockchip.com.cn:2222/repo-release/tools/repo.git

下载后即可获取到 repo:

Is repo/repo

repo/repo

将 repo 拷贝到任意位置,以供下一步使用。建议放到(/home/bin/repo)。

#### 2.2 SDK 下载和同步

使用步骤 2.1 获取的 repo 工程进行初始化。假如 repo 工程目录/home/bin/repo,那么 px3se 工程下载地址如下:

repo init --repo-url=ssh://git@www.rockchip.com.cn:2222/repo-release/t ools/repo.git -u ssh://git@www.rockchip.com.cn:2222/px3-se/manifests.git -m px3\_se\_release.xml

repo sync

#### 3 SDK编译说明

3.1 px3se-slc 小容量存储(小容量推荐使用)

Building kernel

make ARCH=arm px3se\_linux\_slc\_defconfig -j8

make ARCH=arm px3se-slc-sdk.img -j24

**Building rootfs** 



cd buildroot/ && make rockchip\_px3se\_minifs\_defconfig -j8 &&

cd .. && ./build\_all.sh

Pack and compress the firmware

./mkfirmware\_minifs.sh px3se-slc-sdk slc

编译的输出固件在工程目录 rockimg/Image-slc:

rockimg/Image-slc/

Firmware.img

px3se\_usb\_boot\_V1.22.bin

3.2 px3se emmc 大容量存储 (大容量推荐使用)

**Building uboot** 

make px3se\_linux\_defconfig && make -j12

Building kernel

make ARCH=arm px3se\_linux\_defconfig -j8

make ARCH=arm px3se-sdk.img -j24

Build rootfs and app

cd buildroot && make rockchip\_px3se\_defconfig && cd ...

&& ./build\_all.sh && ./mkfirmware.sh

编译的输出固件在工程目录的 rockimg/下:

rockimg/

Kernel.img

parameter-emmc.txt

Px3SeMiniLoaderAll V2.32.bin

resource.img

Rootfs.img

Uboot.img

3.3 px3se emmc 小容量存储(方便调试小容量,实际量产不常用)

Building kernel

make ARCH=arm px3se\_linux\_emmc\_minifs\_defconfig -j8

make ARCH=arm px3se-emmc-minifs-sdk.img -j24

**Building rootfs** 



cd buildroot/ && make rockchip px3se minifs defconfig -j8 &&

cd .. && ./build\_all.sh

Pack and compress the firmware

./mkfirmware minifs.sh px3se-emmc-minifs-sdk emmc

编译的输出固件在工程目录 rockimg/Image-emmc:

rockimg/Image-emmc/

Firmware.img

px3se\_usb\_boot\_V1.22.bin

3.4 px3se sfc 小容量存储 (spi nor flash 使用)

Building kernel

make ARCH=arm px3se\_linux\_sfc\_defconfig -j8

make ARCH=arm px3se-sfc-sdk.img -j24

**Building rootfs** 

cd buildroot/ && make rockchip\_px3se\_minifs\_defconfig -j8 &&

cd .. && ./build all.sh

Pack and compress the firmware

./mkfirmware\_minifs.sh px3se-sfc-sdk sfc

编译的输出固件在工程目录 rockimg/Image-sfc:

rockimg/Image-sfc/

Firmware.img

px3se\_usb\_boot\_V1.22.bin

3.5 px3se slc 小容量存储按多分区编译

为了适应产品缩短开机时间,对 px3se 的 slc nand 提供多分区的编译方式:编译之前做如下修改:

➤ 在工程的 kernel/下对描述 nand 的设备信息节点做如下修改:



➤ 在工程 buildroot/下对 rootfs 的配置文件做如下修改:

```
+++ b/configs/rockchip_px3se_defconfig
@@ -114,12 +114,7 @@ BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_WPS=y
BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_CLI=y
BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_WPA_CLIENT_SO=y
BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_PASSPHRASE=y
-BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
-BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
+BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set
BR2_PACKAGE_HOST_VBOOT_UTILS=y
BR2_PACKAGE_LIBXML2=y
-BR2_PACKAGE_STRESS=y
-BR2_PACKAGE_STRESS=y
-BR2_PACKAGE_GLMARK2=y
-BR2_PACKAGE_MEMTESTER=y
```

▶ 在工程根目录下对 mkfirmware.sh 做如下修改:

```
+++ b/mkfirmware.sh

@@ -4_15 +4_19 @@ IMAGE_RELEASE_PATH=$(pwd)/rockimg/Image-release
KENNEL_PATH=$(pwd)/kernel
UBOOT_PATH=$(pwd)/w-boot
PRODUCT_PATH=$(pwd)/u-boot
PRODUCT_PATH=$(pwd)/u-boot
PRODUCT_PATH=$(pwd)/u-boot
PRODUCT_PATH=$(pwd)/u-boot
PRODUCT_PATH=$(pwd)/u-boot
PRODUCT_PATH=$(pwd)/u-boot
PRODUCT_PATH=$(pwd)/buildroot/output/target/
+-cp $PRODUCT_PATH/sdcard-udisk-udev/rules.d/add-sdcard-udisk-nand.rules $BUILDROOT_TARGET_PATH/etc/udev/rules.d/add-sdcard-udisk.rules
-cp $PRODUCT_PATH/sdcard-udisk-udev/rules.d/remove-sdcard-udisk-nand.rules $BUILDROOT_TARGET_PATH/etc/udev/rules.d/remove-sdcard-udisk
#cd buildroot && make && cd -
rm -rf $IMAGE_OUT_PATH
mkdir -p $IMAGE_OUT_PATH
echo "Package rootfs.img now"
source $PRODUCT_PATH/mkrootfs.sh
-cp $(pwd)/buildroot/output/images/rootfs.ext4 $IMAGE_OUT_PATH/rootfs.img
-cp $(pwd)/buildroot/output/images/rootfs.squashfs $IMAGE_OUT_PATH/rootfs.img
-cp $(pwd)/buildroot/output/images/rootfs.squashfs $IMAGE_OUT_PATH/rootfs.img
```

➤ 在工程 device/rockchip/px3-se/下,把 rockimg/parameter-emmc.txt 改为 roc kimg/parameter-slc.txt,并做如下修改:

```
root=/dev/rknand_boot rootfstype=squashfs
```

固件编译方式如下:

Building uboot

make px3se linux defconfig && make -j12

Building kernel



make ARCH=arm px3se\_linux\_defconfig -j8

make ARCH=arm px3se-sdk.img -j24

Build rootfs and app

cd buildroot && make rockchip\_px3se\_defconfig && cd ..

&& ./build\_all.sh && ./mkfirmware.sh slc

备注:

若需要编译单个模块或者第三方应用,需对交叉编译环境进行配置。

交叉编译工具位于 buildroot/output/host/usr 目录下,需要将工具的 bin/目录和 arm-rockchip-linux-gnueabihf/bin/目录设为环境变量,在项层目录自动配置环境变量的脚本(只对当前控制台有效):

### source envsetup.sh

输入命令查看:

arm-linux-gcc --version

此时会打印出以下 log 即标志为配置成功:

arm-linux-gcc.br\_real(Buildroot 2016.08.1)

## 4 固件烧写说明

(注: 烧写前,需要安装最新的 usb 驱动,驱动在工程目录

tools/windows/DriverAssitant\_v4.2)

#### **4.1** px3se usb 下载口和串口

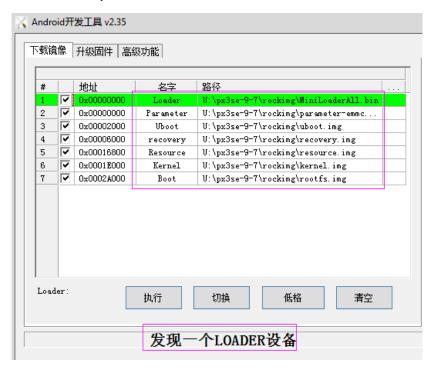






## 4.2 px3se 大容量存储固件烧写

px3se 大容量存储固件烧写工具位于工程目录 tool/windows/AndroidTool。烧写操作步骤:插入 usb 下载线并按住 RESET+ VOL+按键组合进入下载模式(工具底下会提示"发现一个 LOADER 设备"),将固件路径加载后就可以执行烧写。

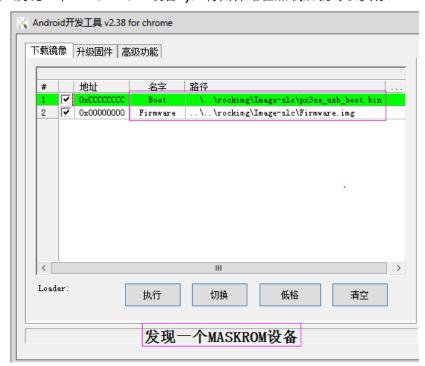


## 4.3 px3se 小容量存储固件烧写

px3se 小容量存储固件烧写工具位于 tool/windows/Minifs\_Tools\_Release\_v1.0



0。烧写操作步骤:插入 usb 下载线并按住 RESET + UPDATE 按键组合进入下载模式(工具底下会提示"发现一个 MASKROM 设备"),将固件路径加载后就可以执行:



## 5 支持列表

#### 5.1 DDR 支持列表

PX3-SE DDR 目前选型列表支持 DDR3、DDR3L、LPDDR2

#### 1.1.4 External Memory or Storage device

- Dynamic Memory Interface (DDR3/DDR3L/LPDDR2)
  - Compatible with JEDEC standard DDR3/DDR3L/LPDDR2 SDRAM
  - Data rates up to 800Mbps(400MHz) for DDR3/DDR3L/LPDDR2
  - Support up to 2 ranks (chip selects) for each channel, totally 4GB(max) address space.
  - 16bits/32bits data width is software programmable
  - 7 host ports with 64bits/128bits AXI bus interface for system access,
     AXI bus clock is asynchronous with DDR clock
  - Programmable timing parameters to support DDR3/DDR3L/LPDDR2 SDRAM from various vendor
  - Advanced command reordering and scheduling to maximize bus utilization
  - Low power modes, such as power-down and self-refresh for DDR3/LPDDR2 SDRAM; clock stop and deep power-down for LPDDR2 SDRAM
  - Compensation for board delays and variable latencies through programmable pipelines
  - Programmable output and ODT impedance with dynamic PVT compensation



#### 5.2 Flash 支持列表

- Nand Flash Interface
  - Support 8bits async/toggle/syncnandflash, up to 4 banks
  - Support LBA nandflash
  - 16bits, 24bits, 40bits, 60bits hardware ECC
  - For DDR nandflash, support DLL bypass and 1/4 or 1/8 clock adjust, maximum clock rate is 66.5MHz
  - For async/togglenandflash, support configurable interface timing , maximum data rate is 16bit/cycle
  - Embedded AHB master interface to do data transfer by DMA method
  - Also support data transfer by AHB slave interface together with external DMAC

#### eMMC Interface

- Compatible with standard iNAND interface
- Support MMC4.41 protocol
- Provide eMMC boot sequence to receive boot data from external eMMC device
- Support FIFO over-run and under-run prevention by stopping card clock automatically
- Support CRC generation and error detection
- Embedded clock frequency division control to provide programmable baud rate
- Support block size from 1 to 65535Bytes
- 8bits data bus width

#### • SD/MMC Interface

- Compatible with SD3.0, MMC ver4.41
- Support FIFO over-run and under-run prevention by stopping card clock automatically
- Support CRC generation and error detection
- Embedded clock frequency division control to provide programmable baud rate
- Support block size from 1 to 65535Bytes
- Data bus width is 4bits

#### 5.2 Wifi 支持列表

PX3SE Wi-Fi Situation												
WiFi Chip	IFACE	IEEE 802.11 Standard	2.4GHz Band	5.0GHz Band	вт	GPS	NFC	11AC	SDIO3. 0	мімо	BT4.0	BT4.2
RTL8723CS/DS	SDIO	IEEE 802.11B/G/N	<b>~</b>	×	<b>~</b>	×	×	<b>✓</b>	×	×	×	<b>&lt;</b>
1. √: 支持	1. √: 支持 ×: 不支持 注: 空的表示没调过											
2. 该列表仅适用kernel3.10												

## 6 兼容硬件 RK SDK MAIN PX3SE CAR V10 版本

注意:目前我们有两个版本硬件,旧 sdk 板(旧板 RK\_SDK\_MAIN\_PX3SE\_CAR\_V10 蓝色板子),新 sdk 板(新板 RK\_SDK\_MAIN\_PX3SE\_CAR\_V11 绿色板子)。服务器上代码默认是支持新板 RK\_SDK\_MAIN\_PX3SE\_CAR\_V11 绿色板子。假如您手上的 sdk 板是旧板,即 RK\_SDK\_MAIN\_PX3SE\_CAR\_V10 蓝色板子,请做以下两个操作(新板 忽略以下两点):



#### 6.1 回退 wifi 提交

在 kernel 目录下面,回退这个提交:

commit b9ebb0d3858fd324225358a72a19b6de924081ad

Author: wjh <wjh@rock-chips.com>

Date: Fri Aug 4 12:37:10 2017 +0800

arm: dts: px3se: wifi module use rtl8723ds

Change-Id: Icfe3dd9863d3bdedf5eb5b3ba17dd29861d2dd57

Signed-off-by: wjh wjh@rock-chips.com

操作命令如下:

git revert b9ebb0d3858fd324225358a72a19b6de924081ad

## 6.2 内置和外置 codec 适配介绍

Codec 适配的介绍,请参考 docs 目录下面《PX3-SE 音频开发文档.pdf》。服务器上默认的代码是适配 RK\_SDK\_MAIN\_PX3SE\_CAR\_V11 绿色板子。

## 7 分区表配置介绍

多分区和 gpt 分区大小配置,请参考 docs 目录下面《PX3-SE 分区表配置说明\_V1.0\_20171102.pdf》

## 8 功能模块说明

#### 8.1 SD 卡/U 盘升级

SD 卡升级和 U 盘升级,请参考 docs 目录下面《PX3-SE\_Recovery 开发说明\_V1.0\_20170908.pdf》和《PX3-SE 大容量 EMMC 升级固件制作说明.pdf》。

#### 8.2 Q/A 文档

开发过程中,会遇到一些常见的问题,docs 目录下面《PX3SE\_Linux 常见问题解决方法\_V1.0.pdf》记录了一些常见的问题。

## 9 量产工具说明

量产固件生成和烧写请参考 docs 目录下面《PX3SE Linux 量产固件生成和下载说明》。

#### 10 工程目录介绍

工程目录下有 buildroot、app、kernel、u-boot、device、docs、external、prebuilts、rockimg、tools 等目录。每个目录或其子目录会对应一个 git 工程,提交需



要在各自的目录下进行。

- 1) buildroot: 用于生成根文件系统、交叉编译工具以及相关工具和应用的管理;
- 2) app: 存放上层应用 app, carmachin 是 SDK 的 Demo 应用;
- 3) external: 相关库,包括音频、视频、网络等;
- 4) kernel: kernel 代码:
- 5) device/rockchip/px3-se: 存放开机初始化脚本,存放第三方库、 bin、 alsa/wifi 等配置文件; 另还存放编译脚本,系统根目录的几个 sh 脚本都是在 repo sync 的时候, 从这里拷贝出来的, 所以若要提交修改的脚本, 必须在 device/rockchip/px3-se 目录下进行;

build\_all.sh:编译所有第三方库和应用;

mkfirmware.sh: 打包最终烧写的固件;

mkfiremware\_mini.sh:打包用于压缩成 Firmware 固件的合成文件;

envsetup.sh: 终端环境变量设置的脚本;

- 6) docs: 存放工程帮助文件;
- 7) prebuilts: 存放编译 kernel 需要的 gcc 和交叉编译工具 toolschain;
- 8) rockimg: 存放编译输出固件;
- 9) tools: 存放平台工具。



## 附录 A 编译开发环境搭建

#### 1. 初始化开发环境

本部分内容包括如何搭建用于 px3se Linux 开发的本地环境。您需要在 Linux 或者 Mac OS 环境下搭建,建议使用 Ubuntu14.04 64ibt 开发,与我司的开发环境统一,避免出现环境问题。

#### 2. 配置一个 Linux 开发环境

本创建步骤是基于最新的 Ubuntu LTS(14.04)版本,但是大部分发行版本必须保证所需的工具可以运行。

注意: 您也可以在虚拟机中搭建环境。如果您在虚拟机中运行 Linux,您需要至少 2GB 的 RAM/swap,或者 30GB 以上的磁盘空间来创建编译环境。

#### 3. 安装所需的安装包(基于 Ubuntu 14.04)

您需要一个 64 位版本的 Ubuntu,推荐使用 Ubuntu14.04。注意:使用老版本 Ubuntu 可能会有兼容性问题。用下面命令来安装 Ubuntu 所需的包:

\$ sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential \ zip tar curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev \ libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 \ libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 cmake tofrodos \ python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 lzop

4.gcc 和 g++版本要求

编译环境的 qcc 和 q++工具版本要求 4.8 以上版本



## 附录 B SSH 公钥操作说明

## 附录 B-1 SSH 公钥生成

使用如下命令生成:

ssh-keygen -t rsa -C "user@host"

请将 user@host 替换成您的邮箱地址。

命令运行完成会在您的目录下生成公钥(id\_rsa.pub)和私钥(id\_rsa)。

```
~$ ls -l .ssh/
总用量 8
-rw------ 1 cody cody 1675 2012-10-15 11:38 id_rsa
-rw-r--r-- 1 cody cody 391 2012-10-15 11:38 id_rsa.pub
```

请妥善保存生成的私钥文件 id\_rsa 和密码,并将公钥 id\_rsa.pub 发邮件给 SDK 发布服务器的管理员。

## 附录 B-2 Git 权限申请说明

参考上述章节,生成公钥文件,发邮件至 fae@rock-chips.com,申请开通 SDK 代码下载权限。